

『M-D リデューサー』

製品番号：100-700／100-701／100-703／100-704／100-705／100-706



『M-D リデューサー』は隣接面の削合（IPR）および研磨を効率的に行うための器具です。歯冠近遠心幅径を適切に縮小することで、歯列弓内に必要なスペースを確保します。また、コンタクトポイントの形成、支台歯形成の調整、修復物・補綴物の余剰除去など、幅広い用途に使用可能です。

本製品は、フレームと交換可能なダイヤモンドコーティング・ステンレススチール製ブレードで構成されています。ブレードを2箇所のピンで固定するシンプルな構造により、切削時のストローク操作を正確にコントロールできます。

ご使用上の注意

- ・ **タイトなコンタクト部への挿入** コンタクトが緊密な部位では、削合を開始する前に、予めブレードをコンタクトポイントに通してから操作を行ってください。
- ・ **平面切削時の保持方法** 平面を削合する際は、削合部位に対してハンドルが水平（平行）になるように保持し、隣接面でブレードが湾曲しないよう注意してください。
- ・ **歯冠形態の形成** 歯冠の形態修正を行う場合は、ハンドルを側方に加圧してブレードを隣接面に沿って湾曲させ、軽いタッチで水平に動かしながら解剖学的な丸みを帯びた表面に仕上げます。
- ・ **部位に応じたブレードの選択** 前歯部・臼歯部ともに同様の手順で使用可能です。症例に応じて片刃、または両面刃を選択してください。
 - 「粗め（Coarse）」：削合用
 - 「細かめ（Fine）」：研磨、およびタイトなコンタクトの微調整用
- ・ **軟組織の保護** フレームが対合歯に接触しないよう注意し、指などで口腔軟組織を保護しながら使用してください。

『M-D リデューサー』の特長

- ・ 優れた操作性：シンプルな構造で、導入後すぐにお使いいただけます。



TP Orthodontics Japan

- ・ 高い制御性：ストロークのコントロールが容易で、精密な切削が可能です。
- ・ 低侵襲：軟組織への損傷リスクを最小限に抑える設計です。
- ・ 豊富なバリエーション：片面・両面それぞれに「粗め」「細かめ」をラインナップし、症例に応じた選択が可能です。
- ・ 多用途に対応：アマルガム、ケイ酸塩セメント、複合レジンなどの削合・除去に適しています。
- ・ 厚みの調整：2枚のブレードを同時に装着することで、削合幅を2倍に設定できます。

滅菌について

- ・ ハンドル部：滅菌する際は、非加熱滅菌法（薬液滅菌等）で行ってください。
- ・ ブレード：本製品のブレードは単回使用製品です。交差汚染のリスクを避けるため、再使用および再滅菌は絶対に行わないでください。

